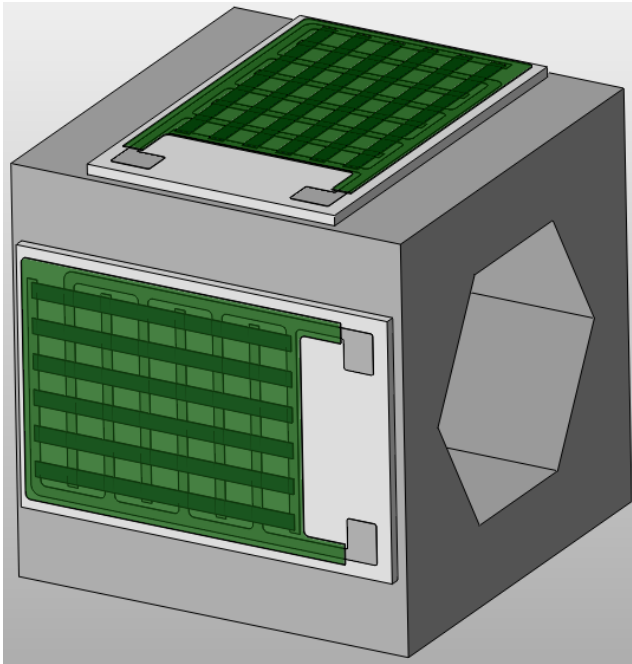


## Charakterystyka



### Cechy

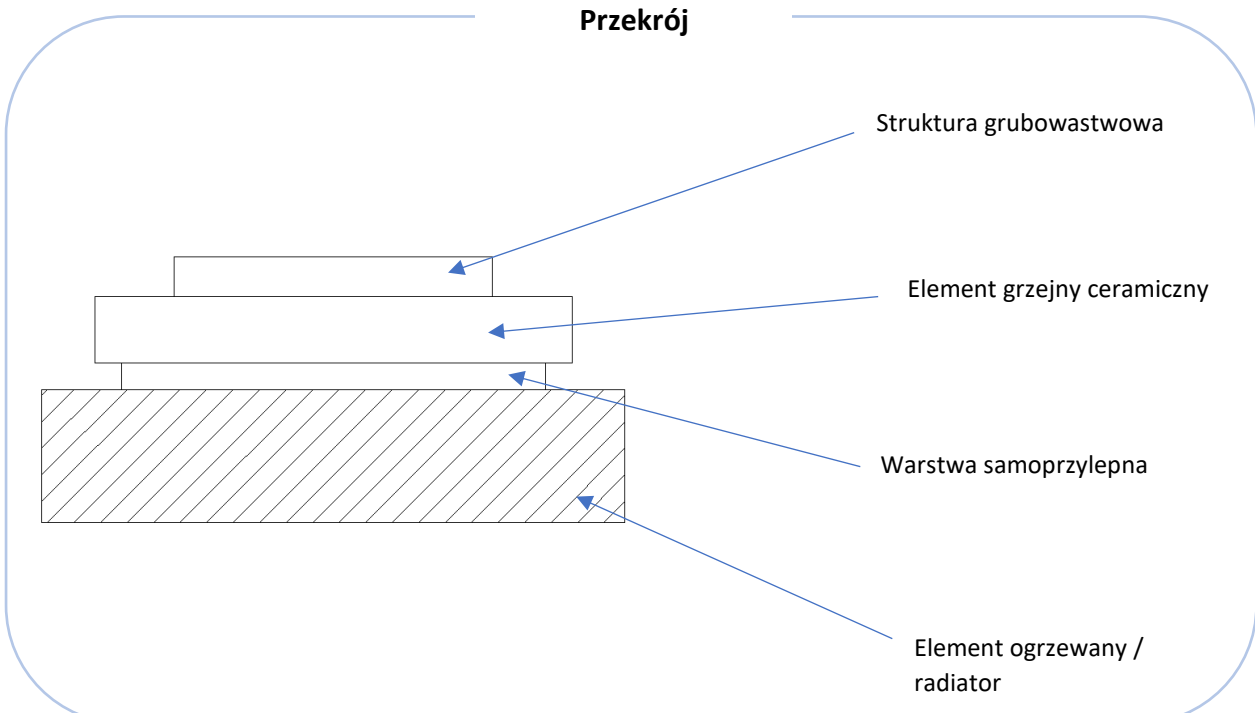
- odporność wysokie temperatury
- odporność na wilgoć oraz rozpuszczalniki
- przylega do całej powierzchni grzejnej
- aplikacja na powierzchni poziomej i pionowej
- łatwy i szybki w montażu
- długa żywotność,
- Zgodny z RoHS, REACH



### Opis

Seria błon klejowych AM o maksymalnej wydajności. Klej akrylowy rozprowadzony na podkładzie z powlekanego polietylenem papieru typu Kraft. Gwarantuje znakomitą przyczepność do metali i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej. Zapewnia pewną początkową możliwość zmiany położenia w celu dokładnego umieszczenia podczas łączenia z tworzywami sztucznymi. Wycinane pod dowolny wymiar. Kompatybilne ze wszystkimi produktami serii GBR. Nie wymaga utwardzania w porównaniu z klejami termoprzewodzącymi. N

### Przekrój



## AM

27.02.2023 / ver. 1.0

## SERIA SAMOPRZYPELNYCH PODKŁADEK DO MONTAŻU

Strona 2 z 2

## Parametry techniczne

	AM-1	AM-2
Typ podkładki	Błona klejowa	Błona klejowa
Przewodność cieplna	0,19 W/mK	0,18 W/mK
Wytrzymałość dielektryczna	647 V/mil	690 V/mil
Grubość kleju	0,13 mm	0,06 mm
Klasa palności	UL94V-0	UL94V-0
Zakres temperatur pracy	-60...200°C	-60...200°C
Kompatybilność	GBR-380	GBR-380
	GBR-387	GBR-387
	GBR-605	GBR-605
	GBR-612	GBR-612
	GBR-666	GBR-666
	GBR-618	GBR-618
	GBR-619	GBR-619
	GBR-620	GBR-620

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym

## Informacje do zamówienia

Seria	-	Obudowa
AM-1		GBR-380
		GBR-387
		GBR-605
		GBR-612
		GBR-666
AM-2		GBR-618
		GBR-619
		GBR-620
		Y - Inne na zamówienie

Przykład: AM-1 – GBR-620

**TELPOD S.A.**  
ul. Piłsudskiego 63A  
32-050 Skawina  
www.telpod.pl

**Dział sprzedaży**  
Tel.: +48 (0)12 257 10 35  
Fax: +48 (0)12 257 10 13  
zamowienia@telpod.pl

**Dział techniczny**  
Tel.: +48 (0)12 257 10 12  
mikrouklady@telpod.pl

